

先进封装与异构集成驱动嵌入式系统创新研讨会

演讲论文征集通知

一、会议背景

Embedded world是全球嵌入式系统领域权威专业平台，汇聚前沿技术展示、高端技术交流与全球产业资源，覆盖嵌入式全产业链生态，秉持by engineers, for engineers（由工程师创办，为工程师服务）核心理念，为产业研发人员、企业决策者提供技术前瞻与落地实践方案。

本届依托国芯展“芯联工业，智创未来”核心定位，举办先进封装与异构集成驱动嵌入式系统创新研讨会，贯通“芯片研发—制造—封测—设备材料—工业终端应用”完整产业链。后摩尔时代，单纯依靠制程微缩已无法满足嵌入式系统高性能、低功耗、小型化发展需求，先进封装、2.5D/3D异构集成、SiP系统级封装成为突破算力瓶颈核心路径；叠加嵌入式AI规模化落地、RISC-V开放架构生态快速扩张，芯片设计、封装集成、终端应用全链条迎来全新机遇与技术挑战。

本次研讨会为期一天，设9至10场技术演讲，聚焦高性能芯片制造、RISC-V定制算力加速、SiP与2.5D/3D异构集成及机器视觉应用，汇聚高校院所专家，打通“制造—封装—嵌入式”全链条，以真实产业需求驱动半导体创新，加速芯片技术向工业终端规模化落地。

二、研讨会议题方向（投稿选题参考，不限于以下）

1. 面向嵌入式AI的高性能芯片制造工艺
2. RISC-V架构嵌入式AI算力解决方案
3. 先进封装技术在嵌入式AI、汽车电子领域落地应用
4. 2.5D/3D EDA工具与STCO协同设计技术
5. SiP系统级封装赋能嵌入式终端小型化、模组化设计
6. 嵌入式机器视觉芯片级软硬件解决方案
7. 高性能嵌入式系统在工业视觉、AI质检的架构设计难点与落地案例
8. 先进封装制程视觉检测难点与智能AOI检测技术方案
9. 车规级嵌入式芯片的封装可靠性与系统集成
10. 嵌入式视觉在具身智能与智能终端的创新应用

三、目标投稿/参会人群

1. 半导体芯片设计、先进封测研发工程师、技术负责人
2. 嵌入式系统工程师、硬件架构师、算法研发人员
3. 模组厂商、整机设备、系统集成企业技术人员
4. 高校、科研院所微电子、嵌入式、AI视觉相关科研人员

四、投稿内容要求

（一）提交材料清单（中英双语，必填）

1. 演讲题目（中英文双语）
2. 演讲摘要：中文约500字，英文约1500字符
3. 演讲人信息：姓名、企业/院校职务、手机号码、电子邮箱
4. 演讲人简介：中文约500字，英文约1500字符

（二）稿件入选标准

1. 入选标准：真实、原创、具有创新视角，尽量是投稿人亲自做过的真实项目。
2. 独家投稿：要求投稿内容未在其他期刊、会议或论文集中发表过，请勿一稿多投。
3. 谢绝营销：主办方不接受以营销为导向以及单纯产品描述的投稿内容。
4. 资料语言：中英文双语对照。请提供演讲资料的中、英文双语版本。

五、关键时间节点

1. 演讲摘要提交截止：2026年09月04日
2. 正式会议议程对外公布：2026年09月30日
3. 终版演讲PPT、完整演讲材料定稿提交：2026年09月23日

六、投稿须知

1. 本次研讨会面向全产业链开放技术演讲征集，优秀投稿将安排现场专题演讲；
2. 所有投稿稿件将由组委会技术专家统一评审，9月30日前统一公示入选演讲嘉宾与完整议程；
3. 投稿材料请整理为双语文档，发送至组委会征集咨询邮箱（event@luminlinkpr.com）；

4. 如有议题方向、材料格式相关疑问，可联系组委会“RPC转呈咨询”沟通。

七、会议价值

- 1. 行业顶级交流平台：依托Embedded world国际平台资源，对接全球嵌入式、半导体上下游企业；
- 2. 全产业链精准对接：覆盖芯片、封测、EDA、嵌入式硬件、工业视觉、汽车电子、AI终端专业听众；
- 3. 技术进展公开分享：面向工程师群体输出技术方案，助力企业/科研机构技术品牌；
- 4. 产业落地资源互通：直面终端厂商、系统集成商，搭建技术成果商业化落地合作渠道。

演讲资料征集表
Speech sponsor – Registration Form

演讲题目： (必填)
Title of the Presentation: (Required)
演讲摘要 (约500字): (必填)
Presentation abstract (about 1500 words) : (Required)
(必填) 演讲人姓名: 职务: 移动电话: 电子邮箱: 演讲人简介 (约500字) :

(Required)

Speaker's Name:

Job Title:

Mobile Phone:

E-mail:

Speaker biography (about 1500 words) :

PS:

温馨提示：准备以上内容时，请不要忽略以下内容：

- 入选标准 - 真实、原创、具有创新视角，尽量是投稿人亲自做过的真实项目。
- 独家投稿 - 要求投稿内容未在其他期刊、会议或论文集中发表过，请勿一稿多投。
- 谢绝营销 - 主办方不接受以营销为导向以及单纯产品描述的投稿内容。
- 资料语言 - 中英文双语对照。请提供演讲资料的中、英文双语版本。

请留意以下重要日期

摘要提交：2026年9月4日前截止

议程公布：2026年9月30日

最终资料及演讲材料定稿：2026年9月23日